



## 2024年5月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2024年4月11日  
上場取引所 東

上場会社名 佐島電機株式会社  
コード番号 7420 URL <https://www.satori.co.jp>  
代表者 (役職名) 代表取締役 社長執行役員 (氏名) 佐島 浩之  
問合せ先責任者 (役職名) 取締役 常務執行役員 (氏名) 諏訪原 浩二 (TEL) 03-3451-1040  
四半期報告書提出予定日 2024年4月11日 配当支払開始予定日 —  
四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無  
四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

### 1. 2024年5月期第3四半期の連結業績(2023年6月1日~2024年2月29日)

#### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年5月期第3四半期	107,357	△0.1	3,512	10.0	2,556	1.2	1,659	△7.2
2023年5月期第3四半期	107,492	15.1	3,193	67.4	2,525	18.9	1,787	16.2

(注) 包括利益 2024年5月期第3四半期 3,187百万円( 23.1%) 2023年5月期第3四半期 2,589百万円( 64.4%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2024年5月期第3四半期	114.15	—
2023年5月期第3四半期	108.62	—

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2024年5月期第3四半期	78,293	33,736	41.4
2023年5月期	81,556	34,945	41.4

(参考) 自己資本 2024年5月期第3四半期 32,436百万円 2023年5月期 33,776百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2023年5月期	—	26.00	—	44.00	70.00
2024年5月期	—	30.00	—	—	—
2024年5月期(予想)	—	—	—	50.00	80.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

### 3. 2024年5月期の連結業績予想(2023年6月1日~2024年5月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	148,500	1.5	4,700	24.0	3,500	22.1	2,400	6.3	165.65

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無  
 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)  
 新規 一社 (社名) 、除外 一社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)	2024年5月期3Q	17,946,826株	2023年5月期	17,946,826株
② 期末自己株式数	2024年5月期3Q	3,622,775株	2023年5月期	1,492,415株
③ 期中平均株式数 (四半期累計)	2024年5月期3Q	14,537,239株	2023年5月期3Q	16,454,574株

(注) 期末自己株式数には、株式報酬制度に関連して信託が保有する当社株式 (2024年5月期3Q 505,100株、2023年5月期 505,100株) が含まれております。また、本信託が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております (2024年5月期3Q 505,100株、2023年5月期3Q 505,100株)。

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料2ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(追加情報)	7
(セグメント情報等)	7
(重要な後発事象)	8
3. その他	9
(1) 製品及びサービスごとの情報	9
(2) 地域別売上高	9

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、地政学リスクの長期化、世界的なインフレ抑制に向けた各国の金融政策の引締めなど先行きが不透明な状況が続いています。

このような環境の中、当第3四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高はSM Electronic Technologies Pvt. Ltd. (以下「SMエレ社」という。)の子会社化による増加に加え、円安の影響等もあり増加したものの、PC需要減に伴う電子部品の売上減少や調達マネジメント事業の減少により、1,073億57百万円(前年同期比0.1%減)となりました。利益面につきましては、営業利益はSMエレ社の子会社化等に伴う売上総利益の増加に加え、円安の影響等により、35億12百万円(前年同期比10.0%増)、経常利益は25億56百万円(前年同期比1.2%増)となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は主に法人税等の増加により16億59百万円(前年同期比7.2%減)となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

なお、第1四半期連結会計期間において経営管理区分を見直し、「モビリティ事業」に区分されていたストレージ部門を「エンタープライズ事業」に区分変更しております。以下の前年同四半期比較については、前年同四半期の数値を変更後の区分により組替えた数値で比較しております。

#### ①産業インフラ事業

売上高は217億43百万円(前年同期比3.4%減)、セグメント利益はアプライドプロダクト事業本部の利益改善により10億96百万円(前年同期比10.2%増)となりました。

#### ②エンタープライズ事業

調達マネジメント事業本部の売上減等により、売上高は372億83百万円(前年同期比22.1%減)、セグメント利益は17億27百万円(前年同期比19.0%減)となりました。

#### ③モビリティ事業

SMエレ社の子会社化および車載向け半導体の好調により、売上高は222億80百万円(前年同期比214.7%増)、セグメント利益は12億87百万円(前年同期比99.5%増)となりました。

#### ④グローバル事業

PC需要減に伴う電子部品の売上減等により、売上高は314億39百万円(前年同期比14.6%減)、セグメント利益は3億39百万円(前年同期比14.3%増)となりました。

### (2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、782億93百万円(前連結会計年度末815億56百万円)となり、32億63百万円減少いたしました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少(11億40百万円)、商品及び製品の減少(18億59百万円)によるものであります。

当第3四半期連結会計期間末における負債は、445億56百万円(前連結会計年度末466億11百万円)となり、20億54百万円減少いたしました。これは主に、流動負債のその他の減少(25億26百万円)によるものであります。

当第3四半期連結会計期間末における純資産は、337億36百万円(前連結会計年度末349億45百万円)となり、12億8百万円減少いたしました。これは主に、為替換算調整勘定の増加(9億18百万円)はあったものの、自己株式の取得による減少(31億78百万円)によるものであります。なお、自己資本比率は、前連結会計年度末と同率の41.4%となりました。

### (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2024年1月15日の「2024年5月期 通期連結業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。

## 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年5月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年2月29日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	10,051	9,282
受取手形及び売掛金	37,070	35,929
商品及び製品	20,628	18,769
仕掛品	446	519
原材料及び貯蔵品	526	371
その他	4,255	4,359
貸倒引当金	△7	△10
流動資産合計	72,972	69,223
固定資産		
有形固定資産	3,004	3,216
無形固定資産		
のれん	492	447
その他	687	639
無形固定資産合計	1,180	1,086
投資その他の資産		
その他	4,975	5,382
貸倒引当金	△576	△615
投資その他の資産合計	4,399	4,767
固定資産合計	8,584	9,070
資産合計	81,556	78,293
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	17,112	17,139
短期借入金	14,279	14,600
未払法人税等	713	360
賞与引当金	—	443
その他	8,444	5,918
流動負債合計	40,550	38,462
固定負債		
社債	1,400	1,400
長期借入金	2,822	2,826
退職給付に係る負債	1,431	1,490
その他	406	376
固定負債合計	6,060	6,093
負債合計	46,611	44,556

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年5月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年2月29日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,611	2,611
資本剰余金	3,447	3,447
利益剰余金	26,322	26,791
自己株式	△1,761	△4,940
株主資本合計	30,620	27,909
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,157	1,618
繰延ヘッジ損益	△44	△53
土地再評価差額金	22	22
為替換算調整勘定	2,021	2,939
その他の包括利益累計額合計	3,156	4,526
非支配株主持分	1,169	1,300
純資産合計	34,945	33,736
負債純資産合計	81,556	78,293

## (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

## 四半期連結損益計算書

## 第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2022年6月1日 至 2023年2月28日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2023年6月1日 至 2024年2月29日)
売上高	107,492	107,357
売上原価	97,395	95,955
売上総利益	10,096	11,402
販売費及び一般管理費	6,903	7,889
営業利益	3,193	3,512
営業外収益		
受取利息	5	65
受取配当金	90	82
受取補償金	174	90
その他	84	53
営業外収益合計	354	291
営業外費用		
支払利息	181	387
債権売却損	383	458
為替差損	373	303
その他	82	98
営業外費用合計	1,021	1,247
経常利益	2,525	2,556
特別利益		
固定資産売却益	—	1
特別利益合計	—	1
特別損失		
段階取得に係る差損	77	—
固定資産除却損	13	—
特別損失合計	90	—
税金等調整前四半期純利益	2,434	2,557
法人税、住民税及び事業税	526	672
法人税等調整額	43	119
法人税等合計	570	792
四半期純利益	1,864	1,765
非支配株主に帰属する四半期純利益	77	106
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,787	1,659

四半期連結包括利益計算書  
第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2022年6月1日 至 2023年2月28日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2023年6月1日 至 2024年2月29日)
四半期純利益	1,864	1,765
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	164	462
繰延ヘッジ損益	△37	△11
為替換算調整勘定	597	970
持分法適用会社に対する持分相当額	△0	—
その他の包括利益合計	725	1,421
四半期包括利益	2,589	3,187
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,518	3,029
非支配株主に係る四半期包括利益	70	157



## (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当社は、第1四半期連結会計期間において、2023年5月9日開催の取締役会決議に基づき、2023年6月28日付で自己株式2,129,900株の取得を行っております。この結果、当第3四半期連結累計期間において、単元未満株式の買取りも含め自己株式が3,178百万円増加し、当第3四半期連結会計期間末において自己株式が4,940百万円となっております。

(追加情報)

(株式の取得に関する契約)

当社は、2024年2月19日開催の取締役会において、オランダの半導体設計会社MAGnetIC Holding B.V.の発行済株式の80.0%を取得（連結子会社化）することを決議し、株式譲渡契約を締結いたしました。

なお、詳細につきましては、2024年2月19日に公表いたしました、「MAGnetIC Holding B.V.の株式取得（子会社化）に関するお知らせ」をご参照ください。

(セグメント情報等)

I 前第3四半期連結累計期間(自 2022年6月1日 至 2023年2月28日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：百万円)

	報告セグメント					調整額 (注) 1	四半期 連結損益 計算書計上 額 (注) 2
	産業 インフラ 事業	エンター プライズ 事業	モビリティ 事業	グローバル 事業	計		
売上高							
顧客との契約から生じる 収益	22,302	41,763	6,694	36,732	107,492	—	107,492
外部顧客への売上高	22,302	41,763	6,694	36,732	107,492	—	107,492
セグメント間の内部売上高 又は振替高	202	6,071	386	80	6,741	△6,741	—
計	22,504	47,835	7,080	36,813	114,234	△6,741	107,492
セグメント利益	994	2,134	645	296	4,071	△877	3,193

(注) 1. セグメント利益の調整額△877百万円には、セグメント間取引消去が含まれております。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(のれんの金額の重要な変動)

第3四半期連結会計期間に持分法適用関連会社であったSM Electronic Technologies Pvt. Ltd.の株式を追加取得し、当社の連結子会社となったことから、モビリティ事業において、のれん270百万円を計上しております。

## Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2023年6月1日 至 2024年2月29日)

## 1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：百万円)

	報告セグメント					調整額 (注) 1	四半期 連結損益 計算書計上 額 (注) 2
	産業 インフラ 事業	エンター プライズ 事業	モビリティ 事業	グローバル 事業	計		
売上高							
顧客との契約から生じる 収益	21,445	32,774	21,734	31,403	107,357	—	107,357
外部顧客への売上高	21,445	32,774	21,734	31,403	107,357	—	107,357
セグメント間の内部売上高 又は振替高	297	4,508	546	35	5,388	△5,388	—
計	21,743	37,283	22,280	31,439	112,745	△5,388	107,357
セグメント利益	1,096	1,727	1,287	339	4,450	△938	3,512

(注) 1. セグメント利益の調整額△938百万円には、セグメント間取引消去が含まれております。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

## 2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(のれんの金額の重要な変動)

重要な変動はありません。

なお、前連結会計年度に実施したSM Electronic Technologies Pvt. Ltd.の株式を追加取得、および子会社における事業の一部の譲受けにより発生したのれんの当第3四半期連結会計期間末の残高は447百万円であります。

## 3. 報告セグメントの変更等に関する事項

第1四半期連結会計期間において経営管理区分を見直し、「モビリティ事業」に区分されていたストレージ部門を「エンタープライズ事業」に区分変更しております。この変更に基づき、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報は、組替えて作成しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 3. その他

## (1) 製品及びサービスごとの情報

前第3四半期連結累計期間(自 2022年6月1日 至 2023年2月28日)

(単位:百万円)

	半導体	一般電子部品	電子機器	製品	合計
外部顧客への売上高	42,420	40,342	21,028	3,701	107,492

当第3四半期連結累計期間(自 2023年6月1日 至 2024年2月29日)

(単位:百万円)

	半導体	一般電子部品	電子機器	製品	合計
外部顧客への売上高	40,565	43,782	20,049	2,960	107,357

## (2) 地域別売上高

前第3四半期連結累計期間(自 2022年6月1日 至 2023年2月28日)

(単位:百万円)

日本	海外							合計
	中国	台湾	インド	タイ	その他 アジア	その他	計	
51,269	33,046	1,337	468	8,818	7,153	5,398	56,223	107,492

(注) 1. 売上高は製品の実際の仕向け地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

2. 「中国」の区分は、香港を含んでおります。

当第3四半期連結累計期間(自 2023年6月1日 至 2024年2月29日)

(単位:百万円)

日本	海外							合計
	中国	台湾	インド	タイ	その他 アジア	その他	計	
47,367	25,051	906	11,187	8,974	9,629	4,239	59,990	107,357

(注) 1. 売上高は製品の実際の仕向け地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

2. 「中国」の区分は、香港を含んでおります。